Fluid delivery system and method

Patent number:

JP2001509648T

Publication date:

2001-07-24

Inventor: **Applicant:** Classification:

- international: H01L21/00; H01L21/00; (IPC1-7): H01L21/205;

C23C14/34; C23C16/448; H01L21/3065

- european:

H01L21/00S2D; H01L21/00S2Z

Application number: JP20000502529T 19980709

Priority number(s): US19970893462 19970711; WO1998US14282

19980709

Also published as:

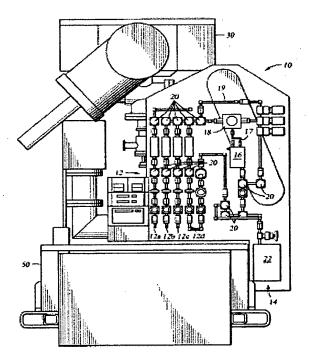
WO9903137 (A EP0996966 (A1 US6083321 (A1

EP0996966 (A0

Report a data error he

Abstract not available for JP2001509648T Abstract of correspondent: US6083321

The present invention generally provides a gas delivery system adapted for positioning near the process chamber. More particularly, the present invention provides an apparatus for processing a substrate that includes a process chamber and a gas delivery system. The gas delivery system is in fluid communication with and is adapted to supply one or more process gases and/or carrier/purge gases to the process chamber. The gas delivery system is positioned proximal the process chamber within about two to three feet of the process chamber.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2001-509648 (P2001-509648A)

(43)公表日 平成13年7月24日(2001.7.24)

(51) Int.Cl.7	識別	記号	FΙ			·-マコード(参考)
H01L	21/205	•	H01L	21/205	•	4K029
C 2 3 C	14/34		C 2 3 C	14/34	M	4 K O 3 O
	16/448			16/448		5 F O O 4
H01L	21/3065		H 0 1 L	21/302	В	5 F O 4 5

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 18 頁)

特願2000-502529(P2000-502529) (21)出願番号 (86) (22)出願日 平成10年7月9日(1998.7.9) (85)翻訳文提出日 平成12年1月6日(2000.1.6) PCT/US98/14282 (86) 国際出願番号 WO99/03137 (87)国際公開番号 平成11年1月21日(1999.1.21) (87)国際公開日 (31)優先権主張番号 08/893, 462 平成9年7月11日(1997.7.11) (32)優先日 米国 (US) (33)優先権主張国 (81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), JP, KR, S G

(71)出願人 アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
APPLIED MATERIALS, INCORPORATED
アメリカ合衆国 カリフォルニア州
95054 サンタ クララ バウアーズ アベニュー 3050

(72)発明者 レイ ローレンスアメリカ合衆国 カリフォルニア州95035 ミルピタス カントリー クラブドライヴ 1594

(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外9名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 流体分配システム及び方法

(57)【要約】

本発明は、一般に処理チャンパの近くに配置するためのガス分配システムを提供する。特に、本発明は、処理チャンパとガス分配システムを有する基板を処理するための装置を提供する。このガス分配システムは、処理チャンパと流体連通しており、1以上の処理ガス及び/又はキャリア/パージ・ガスを処理チャンパへ供給するのに適合されている。このガス分配システムは、処理チャンパから約2~3フィート以内に処理チャンパに接近して配置されている。

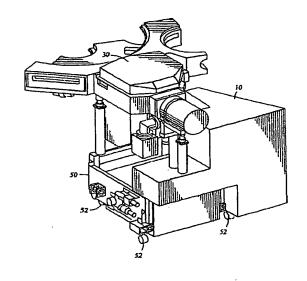


Fig. 2